

## 土井正男先生 講演会のお知らせ

H21.7.30

化学工学会 材料・界面部会 塗布技術研究会

皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、9/16～18に行われます第41回化学工学会秋季大会(広島大学)にあわせ、東京大学大学院にてご活動されている、土井正男先生の講演会を、塗布技術研究会にて企画いたしました。

土井正男先生は、東京大学大学院工学系研究科教授としてご活動されており、最近の研究内容として、  
(1)ソフトマター物理:高分子、液晶、コロイド、ゲルなどの柔らかな物質の研究、

微少領域の流動現象 (基板上的液滴の蒸発、流れ、ゲル化、すべり、粘着、剥離)

ゲルのダイナミクス (ゲルの界面現象、電極界面、ヘテロゲル界面)

(2)計算機材料設計:マルチスケールモデリング 統合プラットフォーム OCTAプロジェクト(NEDO)

等に取り組まれています。詳細はリンクをご参照ください。 <http://rheo.t.u-tokyo.ac.jp/modules/top/>

今回は、「基板上的高分子液滴の乾燥ダイナミクス」というタイトルで、下記についてご紹介いただく予定です。

- 1・高分子液滴の蒸発速度
- 2・高分子液滴の乾燥ダイナミクスと乾燥後のフィルム形状
- 3・計算機シミュレーション
- 4・未解決問題:接触線の運動

尚、講演後、先生を囲んでの懇親会も準備しております。多数のご参加をお待ちしております。

### 記

講演会日時 : 平成21年9月17日(木)  
17:30～ 講演会  
19:30～ 懇親会 (2時間程度)

場所 : 西条HAKUWAホテル  
〒739-0047 東広島市西条下見 6-5-45(広島大学正門前)  
TEL.082-431-1111 FAX.082-431-445

講演会参加費 : 企業関係者 6,000 円、大学関係者 5,000 円(懇親会費含む)  
講演会のみ、もしくは懇親会のみのご参加も歓迎いたします。参加費は、それぞれ、企業関係者 4,000 円、大学関係者 3,000 円とさせていただきます。  
(参加費は講演当日、現地にて現金で徴収させていただきます。)

申し込み方法 : 次ページフォームを利用し、E-mail もしくは FAX にて塗布研究会事務局(窓口 本多)まで申し込みください。

申し込み〆切り: 平成 21 年 8 月 24 日〆切といたします

[化学工学会 第 41 回秋季大会講演プログラム](#)

以上

(会場周辺地図)

